```
T S1/7
  1/7/1
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
010229994
WPI Acc No: 1995-131251/199517
 Gas barrier film for preserving and heating food - comprises base film,
 transparent inorganic layer, barrier resin coating layer and optional
 heat sealing layer
Patent Assignee: DAICEL CHEM IND LTD (DAIL )
Inventor: MURAI T; MURAKAMI T; SAKAI Y
Number of Countries: 008 Number of Patents: 006
Patent Family:
                   Date
                           Applicat No
Patent No
             Kind
                                          Kind Date
                                                          Week
WO 9507815
             A1 19950323 WO 94JP1525
                                          A 19940916 199517
             A 19950328 JP 93255084
JP 7080986
                                          A 19930916 199521
JP 7285191
             A 19951031 JP 94104613
                                          A 19940419 199601
             Α
                                          A 19940914 199608
TW 264494
                  19951201 TW 94108463
JP 3219570
             B2 20011015 JP 93255084
                                           A 19930916 200164
           B2 20031006 JP 94104613
                                           A
JP 3454566
                                               19940419 200367
Priority Applications (No Type Date): JP 94104613 A 19940419; JP 93255084 A
Cited Patents: EP 311432; JP 1095038; JP 1165434; JP 1184127; JP 1202435;
  JP 1202436; JP 1267032; JP 1283135; JP 2034328; JP 2058023; JP 60244540;
  US 5100720
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                        Main IPC
                                    Filing Notes
WO 9507815
             A1 J 35 B32B-009/04
   Designated States (National): CN KR US
   Designated States (Regional): DE FR GB
                    7 B32B-009/04
JP 7080986
           Α
JP 7285191
             Α
                    9 B32B-009/00
TW 264494
           Α
                    C08J-007/04
JP 3219570 B2
                   7 B32B-009/04
                                    Previous Publ. patent JP 7080986
JP 3454566
             B2
                   10 B32B-009/00 Previous Publ. patent JP 7285191
Abstract (Basic): WO 9507815 A
        A gas barrier film comprises a base film having 1 side covered with
    an intermediate transparent inorganic layer and a barrier resin coating
    layer. ] Also claimed is the mfr. the above gas-barrier film.
        USE - Used as wrapping film for preserving food, heating food by
    microwave oven or retorting (claimed), medicines, precision electrical
    components, and so forth.
        ADVANTAGE - The film has excellent gas barrier and transparency
    properties which are maintained even at high temperature and under
    mechanical force such as bending or crumpling.
        Dwg.0/0
Derwent Class: A32; A92; P73; Q34
International Patent Class (Main): B32B-009/00; B32B-009/04; C08J-007/04
International Patent Class (Additional): B32B-027/28; B32B-027/30;
  B65D-065/40
?
```

国際事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類 5 B32B 9/04			(11)	国際公開番号	is	WO 95/07815
B32B 9/04		A1				
			(43)	国際公開日		1995年3月23日 (23.03.95)
(21)国際出顧番号 (22)国際出顧日	PCT/J 1994年9月16日(添付公開書類		国院建查報告書
特額平6/104613 (71) 出頭人(米国を除くすがイセル化学工業株式会社(DAICEL CHEMICAL 〒590 大阪府堺市鉄砲町1(72) 発明者: および(75) 発明者/出願人(米村井孝明(MURAI, Taka:〒739-06 広島県大竹市砂酒井泰正(SAKAI, Yasur〒666-01 兵庫県川西市福村上 禎(MURAKAMI, Ta〒661 兵庫県尼崎市大屋3(74)代理人 井理士 執田充生,外(KUW〒530 大阪府大阪市北区天行のsaka,(JP)	INDUSTRIES, LTD.) (JP/J番地 Osaka, (JP) 国についてのみ) aki)(JP/JP) は故8-3-2 Hiroshima, (J masa)(JP/JP) 即台西4-2-72 Hyogo, (J	P)	115			
(81)指定国 (ON, KR, US, 欧州特許(DE, I	FR, GB	, .			

(54) Title: GAS-BARRIER FILM AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称 ガスパリア性フィルムおよびその製造方法

(57) Abstract

A gas-barrier film is produced by covering at least one side of a base film, such as a polyester film, with a transparent inorganic layer such as a silicon oxide and then with a barrier resin coating layer such as a vinylidene chloride copolymer or an ethylene-vinyl alcohol copolymer. A heat-sealing layer may be formed on the barrier resin coating layer or the other side of the base film. The thickness (n1) of the inorganic layer is $0.01 - 0.5 \,\mu m$ and that (n2) of the coating layer is $0.05 - 15 \,\mu m$, the ratio of n2 to n1 being 0.1 to 1,500. The obtained film withstand the lowering of the gas-barrier properties even when acted upon by an external mechanical force such as crumpling. The film is suitable for preserving food for long, because it can retain high transparency and gas-barrier properties even when it has a thin covering layer and is heated by retorting or in a microwave oven.

(57) 要約

ポリエステルなどの基材フィルムの少なくとも一方の面を、ケイ素酸化物などの透明性を有する無機質層と、塩化ビニリデン系共重合体、エチレンービニルアルコール共重合体などのバリア性樹脂コーティング層とで順次被覆し、ガスバリア性フィルムを得る。前記パリア性樹脂コーティング層又は基材フィルムの他方の面には、ヒートシール層を形成してもよい。無機質層の厚さ n 2 は 0 . 0 1 ~ 0 . 5 μm、バリア性樹脂コーティング層の厚さ n 2 は 0 . 0 5 ~ 1 5 μmであり、厚さの割合 n 2 / n 1 は 0 . 1~1500である。得られたフィルムは、揉みなどの機械的外力が作用してもガスバリア性の低下を抑制できる。被覆層が薄いフィルムを、レトルト処理や電子レンジなどにより加熱しても、高い透明性やガスバリア性を維持するので、食品の長期保存に適する。

情報としての用途のみ PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

アルメニア オーストリア オーストラリア パンパドス リヒテンシュタイン スリランカ リベリア ポルトガル ルーマニア ロシア連邦 エストニア スペイン フィンランド フランス AT AU BB E E E S F I LRT LUV LC MD スーダンプスウェーデンスロヴェニア SD BBBBBBBCCCCCCCCD ベルギ・ F G G G G G H I I ルクセンブルグ ラトヴィア モナコ モルドパ SE ブルギナ・ファソ ブルガリア イギリス スロヴェート スロヴェート スロヴガル スマジランド スヤード チャーゴ ブラジル ベラルーシ マダガスカル SZ TD TG TJ TT UG マーノ ギリシャ ハンガリ アイルランドイタリー で、 中央アフリカ共和国 コンゴー モーリタニア マラウイ メキシコ トージャスタン トリニダード・トバゴ ウリライナ ウガンダ 米国 MR MW I P K K K K R スイス コート・ジボアール カメルーン 中国 MX NE N L N O N Z 朝鮮民主主義人民共和国 ズベキスタン共和国 ・ロ チェッコ共和国 ドイツ 大学民国 -ランド

1

明細書

ガスバリア性フィルムおよびその製造方法

技術分野

本発明は、透明性を有し、水蒸気や酸素などに対するガスバリア 5 性に優れ、食品のレトルト処理や電子レンジ加熱用フィルム、医薬 品、精密電子部品などの包装フィルムとして好適なガスバリア性フィルムおよびその製造方法に関する。

背景技術

10 食品、医薬品、精密電子部品などに用いられる包装フィルムは、 内容物の視認性や美観性などのために、高い透明性が要求されると 共に、吸湿や酸化などによる内容物の変質などを防止するため、ガ スバリア性が必要とされる。

近年、電子レンジの普及に伴ない、調理済みまたは半調理食品

15 (以下、調理食品と総称する)が、包装されたまま電子レンジで加熱され、食前に供されている。また、前記調理食品は、包装後にレトルト処理される場合も多い。このような包装材料には、レトルト処理及び電子レンジでの加熱に耐える必要がある。また、食品の品質の劣化を防ぐために、水蒸気、酸素などに対する高いガスバリア

20 性を有するとともに、内容物の視認のための高い透明性が要求される。

そこで、特開昭55-59961号公報には、ポリエステルフィルムやポリプロピレンフィルムなどの基材フィルムの表面に、塩化ビニリデンやエチレンービニルアルコール共重合体などのガスバリア性の優れたポリマーをコーティング又はラミネートしたフィルムが開示されている。また、包装材料として、例えば、ガスバリア性を有する塩化ビニリデン系ポリマーフィルム又は塩化ビニリデン系

ポリマーでコーティングしたフィルムなどと、ヒートシール性を有する無延伸ポリプロピレンフィルムなどとをラミネートした複合フィルムも提案されている。

ガスバリア性ポリマーを積層したフィルムは、透明性に優れ、内 5 容物を透視できるものの、水蒸気、酸素などに対するガスバリア性 が未だ十分でない。特に、高温においては、水蒸気、酸素ガスなど に対するガスバリア性が著しく低下する。そのため、調理食品の長 期保存用には適さない。

また、ガスバリア性を向上させるため、塩化ビニリデン系ポリマー層の厚さを厚くすると、電子レンジで加熱する場合、フィルムでのマイクロ波の損失が増加し、加熱時間が長くなるだけでなく、フィルムコストが高くなる。特に、レトルト処理や電子レンジ加熱により高温(例えば、110℃以上の温度)に晒されると、塩化ビニリデン系ポリマーの耐熱性が小さいため、水蒸気、酸素ガスなどに15対するガスバリア性が著しく低下する。そのため、レトルト食品包装や電子レンジ加熱用食品の包装には適さない。さらに、高温下で白化し、透明性が低下するため、内容物の視認性が低下する。

一方、特開昭62-152746号公報には、ポリエチレンテレフタレートなどの基材フィルムに、錫などの金属蒸着層を形成した20フィルムや、アルミニウム箔とポリプロピレンフィルムなどとをラミネートした包装用フィルムが提案されている。金属層を積層したフィルムは、ガスバリア性に優れ、レトルト食品の包装に利用されているものの、透明性を有さず、しかも導電性を有するために電子レンジによる加熱を行なうことができない。

25 また、基材フィルムに無機質の薄膜を形成した複合フィルムも提案されている。例えば、特公昭53-12953号公報、特開平4-173137号公報には、酸化ケイ素を蒸着したフィルムが提案され、特開平1-297237号公報には、フッ化マグネシウムなどを真空蒸着したフィルムが提案されている。しかし、このような

複合フィルムにおいて、水蒸気、酸素などに対するガスバリア性を高めるために無機質層の膜厚を厚くすると、透明性が低下するとともに、可撓性が低下し亀裂や剥離が生じる。一方、透明性を確保するために膜厚を薄くすると、十分なガスバリア性が得られない。

- 5 前記特開平4-173137号公報には、ポリ塩化ビニリデンコートポリエチレンテレフタレートにケイ素酸化物を蒸着した複合フィルムも開示されている。しかし、このようなフィルムでは、表層の無機質薄膜に、折曲、揉みなどにより機械的外力が作用すると、剥離や欠陥部を生じるため、ガスバリア性が大きく低下する。
- 10 特開昭63-237940号公報には、酸化インジウムや酸化スズなどをスパッタリングしたフィルムに、エチレン-プロピレン共重合体などのヒートシール層を形成した複合フィルムが開示されている。

特開平1-202435号公報や特開平1-202436号公報には、基材フィルムの表面に、ケイ素酸化物の蒸着層と、ヒートシール層又は保護層とを形成した電子レンジ用包装材料やレトルト食品用包装材料が開示され、前記ヒートシール層は、ポリプロピレンなどのヒートシール性樹脂フィルムのラミネートにより形成され、保護層は、フィルムのラミネートや、熱硬化性樹脂のコーティングにより形成されている。しかし、無機酸化物層にヒートシール層や保護層を形成したフィルムは、未だガスバリア性が低く、酸素透過率1g/m²・24hr程度に過ぎない。そのため、長期保存が必要な食品の包装には未だ適さない。また、樹脂フィルムをラミネートしているため、フィルム25の厚みが大きくなる。

特開平4-89236号公報には、基材フィルム表面に、ケイ素酸化物の蒸着層を2層以上積層し、更にその表面を、前記先行文献と同様の保護層又はヒートシール層で被覆した包装材料が提案されている。しかし、このような包装材料の製造には、2回以上の蒸着

工程を要する。しかも、蒸着膜を酸素を含む雰囲気に晒すため、蒸 着工程毎に装置を常圧に戻して、フィルムを取り出す必要があり、 製造工程が煩雑であるだけでなく、コスト高となる。

このように、従来のフィルムは、加工や使用に伴う機械的外力の 5 作用によるガスバリア性の低下を抑制することが困難である。特に、 可撓性や透明性に加えて、被覆層が薄くても優れたガスバリア性を 有するフィルムを得ることができず、内容物の保護効果及び内容物 の視認性が未だ不十分である。

従って、本発明の目的は、被覆層が薄くても、優れたガスバリア 10 性及び透明性を有するガスバリア性フィルムおよびその製造方法を 提供することにある。

本発明の他の目的は、高温においても高いガスバリア性を有するとともに、可撓性に優れ、折曲や揉みなどの機械的外力が作用しても、ガスバリア性の低下を抑制できるガスバリア性フィルムおよび 75 その製造方法を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、高温に晒されても、透明性やガスバリア性の低下を抑制できるとともに、劣化や変質を抑制しつつ内容物を長期保存できるガスバリア性フィルムおよびその製造方法を提供することにある。

20 本発明の他の目的は、電磁波加熱におけるマイクロ波の損失を抑制でき、電磁波加熱やレトルト処理などに供される食品などを包装する上で有用なガスバリア性フィルムおよびその製造方法を提供することにある。

25 発明の開示

本発明者らは、前記目的を達成するため、鋭意検討した結果、基材フィルム層の表面に形成した無機質層を、ガスバリア性の高い樹脂でコーティングすると、透明性や可撓性だけでなく、被覆層が薄くても、ガスバリア性に優れ、しかも、機械的外力の作用や高温下

でもガスバリア性が低下しないフィルムが得られることを見いだし、 本発明を完成した。

すなわち、本発明のガスバリア性フィルムは、基材フィルム層の少なくとも一方の面が、透明性を有する無機質層を介して、バリア 性樹脂コーティング層で被覆されている。前記基材フィルム層は、種々のポリマー、例えば、オレフィン系ポリマー、ポリエステル、ポリアミドなどで形成できる。透明性を有する無機質層は、例えば、周期表2A族元素、2B族元素、3B族元素、4B族元素、6B族元素などの種々の金属単体又はその無機化合物で構成できる。さら10 に、バリア性樹脂コーティング層は、塩化ビニリデン系共重合体、エチレンービニルアルコール共重合体などのガスバリア性樹脂を含む塗布液を塗布することにより形成できる。

前記基材フィルムの他方の面またはバリア性樹脂コーティング層は、ヒートシール層で被覆してもよい。

- 15 前記無機質層の厚みは100~5000オングストローム程度、バリア性樹脂コーティング層の厚みは0.05~15μm程度、あってもよい。また、無機質層の厚さ n 1 (μm)に対するバリア性樹脂コーティング層の厚さ n 2 (μm)の割合 n 2 / n 1 は0.1~1500程度の範囲から選択できる。
- 20 なお、本明細書において、「バリア性樹脂コーティング層」とは、厚さ2μmにおいて、温度25℃で酸素ガス透過率20cc/m²・24時間以下、温度40℃、90%相対湿度で水蒸気透過率20g/m²・24時間以下のバリア性樹脂を含む層を意味する。また、「ヒートシール層」とは、ヒートシーラーによる熱接合に限らず、
- 25 インパルスシール、高周波接合、超音波接合などの方法により熱接 合可能な層を意味する。

発明の詳細な説明

基材フィルム層(1)を構成するポリマーとしては、成膜可能な

種々のポリマー、例えば、ポリエチレン、エチレン-アクリル酸エ チル共重合体、アイオノマー、ポリプロピレン、...エチレンープロピ レン共重合体、ポリー4-メチルペンテン-1などのポリオレフィ ン;ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン-2,6-ナフタ 5 レート、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル;ナイロ ン6、ナイロン11、ナイロン12、ナイロン66、ナイロン61 0、ナイロン6/66、ナイロン66/610などのポリアミド: 芳香族ポリアミド;ポリ塩化ビニル;ポリ塩化ビニリデン、塩化ビ ニリデンー塩化ビニル共重合体、塩化ビニリデンーアクリロニトリ ル共重合体、塩化ビニリデン-(メタ)アクリル酸エステル共重合 10 体などの塩化ビニリデン系樹脂;ポリスチレン、スチレン-アクリ ロニトリル共重合体、スチレン-アクリロニトリループタジエン共 重合体などのスチレン系樹脂;ポリビニルアルコール;ポリアミド イミド;ポリイミド;ポリエーテルイミド;ポリカーボネート;ポ 15 リスルホン;ポリエーテルスルホン;ポリエーテルエーテルケトン; ポリアリレート; ポリフェニレンスルフィド; ポリフェニレンオキ シド;ポリパラキシレン;ポリアクリロニトリル;ポリテトラフル オロエチレン、ポリトリフルオロクロロエチレン、フッ化エチレン - プロピレン共重合体などのフッ素樹脂;セロハンなどのセルロー 20 ス系ポリマー;塩酸ゴム;前記種々のポリマーの構成成分を含む共 重合体などが例示される。これらのポリマーは、一種または二種以 上を混合して用いることができる。

基材フィルム層の光線透過率は、適当に選択でき、包装内容物の 視認性と美観のためには、白色光線での全光線透過率が、通常、4 25 0%以上、好ましくは60%以上、より好ましくは80%以上であ ることが望ましい。

基材フィルム層(1)は、オレフィン系ポリマー(特にポリプロピレン系ポリマーなど)、ポリエステル(特にポリエチレンテレフタレート)、ポリアミド、スタレートなどのポリアルキレンテレフタレート)、ポリアミド、ス

チレン系ポリマー、エチレンービニルアルコール共重合体、ポリカーボネート、ポリアクリロニトリルなどで構成されているのが好ましい。オレフィン系ポリマー、ポリエステル、ポリアミドは、透明性、機械的強度及び包装適性に優れる。

5 レトルト処理、電磁波加熱用食品の包装材料には、透明性、機械的強度及び包装適性に優れる耐熱性の高いポリマー、例えば、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミド、エチレンービニルアルコール共重合体、ポリカーボネート、ポリアクリロニトリルなどが好ましい。特に好ましい基材フィルム層(1)を構成するポリマーに10 は、ポリエステル、ポリアミドなどが含まれる。

基材フィルム層は、単層フィルムであってもよく、二種以上のポリマー層が積層された積層フィルムであってもよい。基材フィルム層の厚みは特に制限されず、包装適性、機械的強度、可撓性などを考慮して適宜選択される。基材フィルム層の厚みは、通常、3~20μm、好ましくは5~100μm、さらに好ましくは10~50μm程度である。

基材フィルム層は、慣用のフィルム成形方法、例えば、インフレーション法、Tダイ法などの溶融成形法や、溶液を用いたキャスティング法などで形成できる。また、基材フィルム層は、未延伸であってもよく、一軸または二軸延伸処理されていてもよい。延伸法としては、例えば、ロール延伸、圧延延伸、ベルト延伸、テンター延伸、チューブ延伸や、これらを組み合わせた延伸などの慣用の延伸法が適用できる。延伸倍率は、所望するフィルムの特性に応じて適宜設定でき、例えば、少なくとも一方の方向に1.5~20倍、好25 ましくは2~15倍程度である。

基材フィルム層の少なくとも一方の面は、表面処理されていてもよい。表面処理としては、コロナ放電処理、プラズマ処理、グロー放電処理、逆スパッタ処理、火炎処理、クロム酸処理、溶剤処理、粗面化処理などが例示される。尚、基材フィルム層のうち、表面処

理を施した面に、無機質層及びバリア性樹脂コーティング層を形成 すると、密着性を高めることができる。

また、基材フィルム層の表面には、表面処理に代えて、又は表面の表面には、下塗層が形成されている層はといって塗層が形成されていた性樹脂、光線硬化性樹脂、光線硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂など)や、カップリング剤などができる。下塗層の成分の具体的としては、例えば、アクリル系樹脂、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアを増加した。ポリカーボネート、ニトロースやセルイン酸樹脂、カードなどのセルロース系ポリマー、マヤセンイン酸樹脂でカートなどのセルロース系ポリマン変性マレイン酸樹脂で、水の熱可塑性樹脂;ロンタン系樹脂、アルキッド系樹脂では、尿素ーメラミン系樹脂;エポキシ(メタ)アルキッド系樹脂などの熱硬化性樹脂;エポキシ(メタ)アルキッド系樹脂などの熱硬化性樹脂;エポキシ(メタ)アルキッド系樹脂などの熱硬化性樹脂;エポキシ(メタ)アリレート、ウレタン(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート、ウレタン(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート、カレタン(メタ)アクリレート、ウレタン(メタ)アクリレート、カレタン(メタ)アクリレートなどの光硬化性樹脂;シランカップリング剤などができる。これらは、一種または二種以上用いることができる。

下塗層の形成方法は特に限定されず、前記下塗層の成分を含む有機又は水性コーティング剤を、ロールコーティング法、グラビアコーティング法、リバースコーティング法、スプレーコーティング法 などの慣用のコーティング法により塗布し、乾燥または硬化することによって行なわれる。なお、光硬化性樹脂を用いる場合には、活性光線を照射すればよい。

本発明の主たる特色は、透明性を有する無機質層 (2) と、バリア性樹脂コーティング層 (3) とを組み合わせて、基材フィルム

(1)の表面を特定の順序で被覆する点にある。この複合構成により、機械的外力の作用時や高温において、透明性およびガスバリア性の低下を抑制でき、高い可撓性とともに、前記被覆層が薄くても、優れたガスバリア性を有するフィルムが得られる。特に、前記構成のフィルムは、基材フィルム層に、被覆順序を異にして、バリア性樹脂コーティング層と無機質層とを形成したフィルムに比べて各段に高い性能を示す。基材フィルム層にこのことは、次のように考えられる。

すなわち、本発明のフィルムは、透明性を有する無機質層(2) 10 とバリア性樹脂コーティング層(3)との親和性が高い。そのため、 無機質層が単一層であり、かつ被覆層が極めて薄くても、高いガス バリア性が得られるとともに、透明性に優れる。また、可撓性が低 下したり、外力によりガスバリア性の低下をもたらす剥離や欠陥が 生成することがない。さらに、バリア性樹脂コーティング層と無機 15 質層とを組み合わせることにより、高温においても透明性及びガス バリア性の低下を抑制できる。例えば、無機質層とバリア性樹脂コ ーティング層との組み合わせにより、レトルト処理や電磁波加熱な どにより高温に晒されても、例えば、酸素透過率 $1 c c / m^2 \cdot 2$ 4 h r 以下 (好ましくは 0 . 5 c c / m² ・ 2 4 h r 以下) 、水蒸 20 気透過率 $1.0 \text{ g/m}^2 \cdot 24 \text{ h r 以下という高いガスバリア性を}$ 維持できる。しかも、バリア性樹脂コーティング層は、塗布液を塗 布するという簡単な操作で容易に形成できる。さらに、電子レンジ などの電磁波加熱時のマイクロ波の損失が少ないとともに、レトル ト処理などの高温においても、白化が生じない。従って、本発明の フィルムは、例えばフィルムの加工や使用の際に、折曲や揉みなど の機械的外力が作用しても、ガスバリア性の低下を抑制できると共 に、高温においても高いガスバリア性を発揮でき、長期間に亘り、 優れたガスバリア性を維持できる。

無機質層(2)を構成する無機物としては、透明性薄膜を形成で

きる無機物であれば、特に制限されず、例えば、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウムなどの周期表2 A族元素;チタン、ジルコニウム、ルテニウム、ハフニウム、タンタルなどの周期表遷移元素;亜鉛などの周期表2 B族元素;アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウムなどの周期表3 B族元素;ケイ素、ゲルマニウム、錫などの周期表4 B族元素;セレン、テルルなどの周期表6 B族元素などの単体、これらの元素を含む無機化合物、例えば、酸化物、ハロゲン化物、炭化物、窒化物などが挙げられる。これらは、一種または二種以上用いることができる。

10 好ましい無機物には、例えば、マグネシウム、カルシウム、バリウムなどの周期表2A族元素;チタン、ジルコニウム、タンタル、ルテニウムなどの周期表遷移元素;亜鉛などの周期表2B族元素;アルミニウム、インジウム、タリウムなどの周期表3B族元素;ケイ素、錫などの周期表4B族元素;セレンなどの周期表6B族元素の単体、またはこれらを含む酸化物が含まれる。特に周期表3B族元素又は4B族元素の金属単体又はこれらの酸化物により、無機質層が形成されているのが好ましい。

前記無機物のなかでも、前記元素を含む酸化物(例えば、酸化錫、酸化インジウム又はこれらの複合酸化物やケイ素酸化物など)は透20 明性やガスバリア性に優れている。特に、ケイ素酸化物は、前記特性に加えて、緻密な薄膜を形成でき、バリア性樹脂コーティング層を構成するポリマーとの親和性が高く、機械的外力が作用しても、無機質層に亀裂や欠陥が生成せず、高温においても高いガスバリア性を長期間に亘り維持できる。なお、ケイ素酸化物には、一酸化ケイ素や、二酸化ケイ素のみならず、組成式SiOx(式中、O<x≦2)で表されるケイ素酸化物が含まれる。

これらの無機物のうち、電磁波加熱用包装材料においては、導電率の低い無機化合物、例えば、酸化物、ハロゲン化物、炭化物、窒化物などの非導電性無機物が使用できる。好ましい非導電性無機物

には、酸化物、例えば、ケイ素酸化物などが含まれる。

無機質層の厚さは、通常、100~5000オングストローム (0.01~0.5μm)、好ましくは200~3000オングストローム トローム (0.02~0.3μm)、さらに好ましくは300~1500オングストローム (0.03~0.15μm)程度の範囲から選択できる。厚さが100オングストローム未満では、十分なガスバリア性が得られず、5000オングストロームを越えても、バリア性はさほど向上せず、経済的に不利である。

バリア性樹脂コーティング層は、前記の如き高いガスバリア性を 10 示す樹脂、例えば、塩化ビニリデン系共重合体、エチレン-ビニル アルコール共重合体、ポリアミド系重合体、ポリビニルアルコール 系重合体、ポリアクリロニトリル系重合体、ウレタン系重合体など を含んでいる。なお、ガスバリア性樹脂コーティング層のバリア性 樹脂には、前記ガスバリア特性を示さない樹脂、例えば、一般的な ウレタン系重合体などは含まれない。これらのバリア性樹脂は一種 又は二種以上混合して使用できる。

好ましいバリア性樹脂には、例えば、塩化ビニリデン系共重合体およびエチレンービニルアルコール共重合体などが含まれる。塩化ビニリデン系共重合体は、塩化ビニリデンと他の重合性モノマーとしては、例えば、塩化ビニル、酢酸ビニル、クロトン酸、アクリルレート、メチルアクリレート、プロピルアクリレート、バックリレート、イソブチルアクリレート、ブリレート、インブチルアクリレート、ルアクリレート、ベンチルアクリロニトリルといりロニトリル、メタクリル酸や上記アクリレートに対系共重合体、塩化ビニリデンーアクリルト、塩化ビニリデンーアクリレート共重合体、塩化ビニリデンーアクリルト共重合体、塩化ビニリデンーアクリレート共重合体、塩化ビニリデンーアクリレート共重合体、塩化ビニリデンーアクリレート共重

体、塩化ビニリデンーメタクリレート共重合体、塩化ビニリデンー 酢酸ビニル共重合体などが好ましい。塩化ビニリデン系共重合体に おける塩化ビニリデン含量は、通常、85~99重量%、好ましく は90~97重量%程度である。このような塩化ビニリデン系共重 6体は、塩化ビニリデン含量が多いため、加熱処理しても、高い透明性とガスバリア性を維持できる。

エチレン・ビニルアルコール共重合体としては、溶媒可溶性のエチレン・ビニルアルコール共重合体が好ましい。このようなエチレン・ビニルアルコール共重合体において、エチレン含量は、通常、105~50モル%、好ましくは10~45モル%、より好ましくは25~35モル%程度であり、分子量は、例えば、1×10⁴~10×10⁴、好ましくは2×10⁴~7×10⁴、好ましくは4×10⁴~5×10⁴程度である。ケン化度は99.5%以上であるのが好ましい。このような溶媒可溶性エチレン・ビニルアルコール共重合体は、水や、水とアルコールとの混合溶媒に可溶であり、塗布により薄膜を形成できる。

バリア性樹脂コーティング層は、所望のガスバリア性(酸素、水蒸気、二酸化炭素など)に応じて、前記バリア性樹脂(好ましくは塩化ビニリデン系共重合体およびエチレンービニルアルコール共重合体)の少なくとも一つの樹脂を含有してもよく、複数の樹脂を含有してもよい。また、バリア性樹脂コーティング層は、バリア性樹脂を含有する複数の層で構成されていてもよい。例えば、バリア性樹脂コーティング層は、塩化ビニリデン系共重合体を含有する層とを含む複数の工チレンービニルアルコール共重合体を含有する層とを含む複数ので構成されていてもよい。バリア性樹脂コーティング層中のバリア性樹脂の含有量は、50重量%以上、好ましくは75~100重量%、さらに好ましくは90~100重量%程度である。

バリア性樹脂コーティング層の厚さは、フィルムの特性を損なわない範囲で適宜選択でき、例えば、0.05~15μm、好ましく

は 0. 1~10μm (例えば 0. 2~7μm)、より好ましくは 0. 25~5μm (例えば 0. 3~3μm)程度である。コーティング 層の厚さが 0. 05μm未満では高いガスバリア性を付与すること が困難であり、15μmを越えても、さほどガスバリア性が向上せ 5 ず、経済的に不利であるとともに、電磁波加熱時のマイクロ波の損失が大きくなり易い。

無機質層(2)とバリア性樹脂コーティング層(3)との厚さの割合は、適宜設定することができるが、前記厚みの割合は、ガスバリア性に影響する。高いガスバリア性及び耐性を得るためには、無10 機質層の厚さ n1 (μm)に対するバリア性樹脂コーティング層の厚さ n2 (μm)の割合 n2 / n1 は、例えば、0.1~1500、好ましくは0.5~500(例えば、1~200程度)、さらに好ましくは1~100程度であり、2~50程度(例えば、5~50程度)である場合が多い。厚さの割合が前記範囲を外れると、高いガスバリア性を付与するのが困難となり、前記割合が0.1未満では、外力により無機質層に欠陥が生じ易く、1500を越えても、さほどガスバリア性などが向上せず、経済的でない。

バリア性樹脂コーティング層の表面には、必要に応じて、前記基 材フィルム層において例示したような慣用の表面処理が施されてい てもよい。

袋体を容易に形成するため、前記バリア性樹脂コーティング層 (3)はヒートシール層(4)で被覆してもよい。また、ヒートシール層(4)は、基材フィルム層(1)の他方の面に形成してもよい。この場合、基材フィルム(1)の一方の面を、少なくとも前記25 無機質層(2)及びバリア性樹脂コーティング層(3)で被覆すればよい。

ヒートシール層を構成するポリマーとしては、熱接合性ポリマー、 例えば、オレフィン系ポリマー、酢酸ビニル-塩化ビニル共重合体、 ポリエステル、ポリアミド、ゴム系ポリマーなどが挙げられる。こ

れらの熱接合性ポリマーは一種又は二種以上混合して使用できる。 熱接合性オレフィン系ポリマーには、例えば、低密度ポリエチレ ンや直鎖状低密度ポリエチレンなどのポリエチレン、エチレン-ブ テン-1共重合体、エチレン-(4-メチルペンテン-1)共重合 体、エチレン-ヘキセン-1共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重 合体、エチレンー(メタ)アクリル酸共重合体、エチレンー(メタ) アクリレート共重合体、アイオノマー、ポリプロピレン、プロピレ ンープテン-1共重合体、エチレン-プロピレン共重合体、エチレ ンープロピレンープテンー1共重合体、エチレンープロピレンージ エン共重合体、無水マレイン酸変性ポリエチレンや無水マレイン酸 変性ポリプロピレンなどの変性ポリオレフィンなどが挙げられる。 好ましいオレフィン系ポリマーには、エチレン-酢酸ビニル共重合 体、エチレンーアクリル酸エチル共重合体、非晶質ポリオレフィン (例えば、アモルファスポリプロピレンなど) などが含まれる。ラ ミネートによりヒートシール層を形成する場合、好ましい熱接合性 フィルムには、無延伸ポリプロピレンフィルムが含まれる。

熱接合性ポリエステルには、脂肪族ジオールおよび脂肪族ジカル ボン酸のいずれか一方の成分を構成単位として含むポリエステルには、脂肪族ジオールと脂肪族ジカルボン酸を構成成分とする脂肪族ジオールを脂肪族ジカルボン酸の単位を含む場合が多い。脂肪族カルボン酸の単位を含む場合が多い。脂肪族カルボン酸の単位を含む場合が多い。脂肪族カルルボンでリコール、ジュール、ガリコール、ガリコール、ガリコール、ガリコール、ガリコール、ガリコール、ガリコール、ガリコール、オリンガリコール、カリコール、カリコール、カリコール、ポリメチレングリコール、1,6~~、1,2 ガオール、ポリメチレンがリコール、1,6~~、1,2 ガオール、ポリメチレンがリコール、1,6~~、1,2 ガオール、ポリメチレンがリコール、1,5 防族ジカルボン酸、無水コハク酸、アジピン酸、アゼライン酸、バシン酸、スベリン酸、ドデカン酸などの飽和脂肪族ジカルボン酸、スベリン酸、ドデカン酸などの飽和脂肪族ジカルボン酸、スベリン酸、ドデカン酸などの飽和脂肪族ジカルボン酸、スベリン酸、ドデカン酸などの飽和脂肪族ジカルボン酸、スベリン酸、ドデカン酸などの食力を含むポリン酸、カルボン酸、カルボン酸、ボラン酸などの飽和脂肪族ジカルボン

などが挙げられる。

熱接合性ポリアミドとしては、例えば、ナイロン6、ナイロン11、ナイロン12、ナイロン13、ナイロン610、ナイロン612、ナイロン616などや、これらのナイロン原料を用いた共重合5 ナイロン(例えばナイロン6/12など)などが例示される。好ましいポリアミドには、ナイロン11、ナイロン12、ナイロン6/12などが含まれる。

ゴム系ポリマーには、例えば、ブチルゴム、イソブチレンゴム、 クロロプレンゴム、スチレン-アクリロニトリル共重合体、スチレ 10 ン-ブタジエン共重合体、スチレン-アクリロニトリル-ブタジエ ン共重合体などが含まれる。

好ましいヒートシール層用のポリマーには、オレフィン系ポリマー、酢酸ビニル-塩化ビニル共重合体、ポリエステル、ポリアミドなどが含まれる。

15 ヒートシール層の厚さは、包装材料の用途などに応じて、例えば、 3~100μm程度の範囲で適宜選択でき、フィルムのラミネート によりヒートシール層を形成する場合には、例えば、20~100 μm、好ましくは30~80μm程度である。

ヒートシール層は、バリア性樹脂コーティング層の表面の所定の 20 部位、例えば、ヒートシールに供される部位に形成すればよいが、 バリア性樹脂コーティング層の表面全体に形成する場合が多い。ま た、ヒートシール層は、前記のように、基材フィルム層の他方の面 のヒートシール部位又は全体に形成してもよい。

なお、基材フィルム層は、種々の添加剤、例えば、酸化防止剤、 生物線吸収剤、熱安定剤などの安定剤;カチオン系、アニオン系、 ノニオン系、両性帯電防止剤などの帯電防止剤;結晶核成長剤;ス チレン系樹脂、テルペン系樹脂、石油樹脂、ジシクロペンタジエン 樹脂、クマロンインデン樹脂などのクマロン樹脂、フェノール樹脂、 ロジンとその誘導体やそれらの水添樹脂などの炭化水素系重合体; 可塑剤:充填剤;高級脂肪酸アミド、高級脂肪酸とその塩、高級脂肪酸エステル、鉱物系、植物系などの天然ワックズ、ポリエチレンなどの合成ワックスなどのワックス;シリカ系微粉末、アルミナ系微粉末などの無機滑剤、ポリエチレン系微粉末、アクリル系微粉末などの有機滑剤などの微粉末状滑剤;着色剤などを含有していてもよい。

また、バリア性樹脂コーティング層は、他のポリマー、例えば、エチレンー酢酸ビニル共重合体、エチレンーアクリル酸エチル共重合体などのオレフィン系ポリマー;アクリル系ポリマー;スチレン系ポリマー;ポリエステル;ポリアセタール;ポリ酢酸ビニル;ポリ塩化ビニル・塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体;ポリアミド;ウレタン系重合体;アクリロニトリル系重合体;ポリカーボネート;塩素化ポリオレフィン;セルロース系ポリマーなどを含有していてもよい。

15 バリア性樹脂コーティング層、ヒートシール層は、必要に応じて、 前記添加剤を含んでいてもよく、バリア性樹脂コーティング層は、 アンチブロッキング剤;ポリエチレンイミン、ポリイソシアネート などの接着性向上剤などを含んでいてもよい。

本発明のバリア性フィルムは、基材フィルムの少なくとも一方の 20 面を、透明性を有する無機質層とバリア性樹脂コーティング層とで 順次被覆することによって得ることができる。

本発明の他のバリア性フィルムは、基材フィルムの少なくとも一方の面を、透明性を有する無機質層とバリア性樹脂コーティング層とヒートシール層とで順次被覆する方法、または基材フィルムの一方の面を、透明性を有する無機質層とバリア性樹脂コーティング層とで順次被覆し、基材フィルムの他方の面をヒートシール層で被覆する方法により得ることができる。

無機質層は、慣用の方法、例えば、物理的方法(真空蒸着法、反応性蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、イオン

プレーティング法、反応性イオンプレーティング法など)、化学的方法(CVD法、プラズマCVD法、レーザーCVD法など)により、基材フィルムの表面を、前記無機物で被覆することにより形成できる。無機質層は蒸着などの物理的方法により形成する場合が多く、無機質層は基材フィルム層の片面又は両面に形成できる。

また、バリア性樹脂コーティング層は、前記無機質層の表面に、 バリア性樹脂を含有する塗布液を塗布することにより形成できる。 塗布液は、バリア性樹脂の種類に応じて、適当な溶媒を選択するこ とにより調製でき、溶液又は分散液のいずれの形態であってもよい。

10 塩化ビニリデン系共重合体を含有する溶液状の塗布液の溶媒は、 塩化ビニリデン系共重合体の種類に応じて適宜選択でき、例えば、 アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類; ジオキサン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテ ル類;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類;酢 15 酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類;ジメチルホルムアミドな どのアミド類やこれらの混合溶媒が含まれる。また、分散液は、通 常、〇/W型エマルジョンの形態で市販されている。

エチレン・ビニルアルコール共重合体を含有する塗布液は、通常、水及びアルコールの混合溶媒を用いて調製できる。このようなアルコールとしては、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、シクロヘキサノールなどが例示される。

上記塗布液は、前記各種添加剤を含有していてもよく、また、塗布性を高めるため、例えば消泡剤、粘度調整剤などの慣用の添加剤を含有していてもよい。

25 塗布方法は、特に制限されず慣用の方法、例えば、エアーナイフコート法、ロールコート法、グラビアコート法、ブレードコーター法、ディップコート法、スプレー法などが採用できる。前記塗布液を塗布した後、例えば、50~150℃程度の温度で乾燥することにより、バリア性樹脂コーティング層を形成できる。

ヒートシール層は、熱接合性ポリマーの種類などに応じて慣用の方法、例えば、ドライラミネート法、押出しラミネート法、塗布法などにより形成できる。

なお、本発明のガスバリア性フィルムには、フィルムの種類、用途に応じて、種々のコーティング層やラミネート層、例えば、滑性層、帯電防止層、装飾用印刷フィルム層や、ナイロンフィルムなどによる補強層などが形成されていてもよい。

本発明のガスバリア性フィルムは、基材フィルム層の表面を、透明性を有する無機質層とガスバリア性の高いバリア性樹脂コーティング層とで順次被覆しているので、透明性に優れると共に、被覆層が薄くても、ガスバリア性が高い。また、揉みなどの機械的外力が作用したり、高温においても、透明性やガスバリア性の低下を抑制でき、長期間に亘り優れたガスバリア性を発揮できる。

また、ヒートシール層を利用して袋を容易に形成できるとともに、 高いガスバリア性により、内容物を長期保存できる。また、電磁波 加熱時のマイクロ波の損失が小さく、電磁波加熱やレトルト処理な どに供される食品などを、品質の劣化や変質を抑制しつつ、包装で きる。

20 産業上の利用可能性

本発明のガスバリア性フィルムは、高温に晒されても、前記のように高いガスバリア性を示し、透明性が高いという特色がある。そのため、包装材料は、電子レンジ用食品、レトルト食品、冷凍食品、マイクロ波殺菌、フレーババリア、医薬品、精密電子部品などの各種包装用材料や、風船などのバルーン用形成材料などとして好適に用いることができる。また、食品などを包装すると、劣化や変質を抑制しつつ、内容物を長期間に亘り保存できる。

本発明のフィルムを用いた包装体の形態は特に制限されないが、 例えば、ハンバーグ、シューマイ、ギョーザなどの固形物の包装袋、 カレー、スープ、コーヒー、紅茶などの液状物の包装袋として用いることができる。これらの食品を収容した包装袋は、そのまま、レトルト処理また電子レンジ加熱できる。また、酒パックなどの紙製容器の内袋として使用することにより、電子レンジ加熱などにより、

本発明の包装材料による包装形態としては、袋、カップ、チューブ、スタンディングバック、トレイなどの容器、フタ材や、酒、醤油、みりん、油、牛乳、ジュースなどの紙パックの内貼り材などが例示される。

内容物を加熱でき、例えば、いわゆるかんを行なうこともできる。

10

実施例

以下、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により限定されるものではない。

比較例1

15 厚さ12μmの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの 一方の面に、SiOを蒸発源として、5×10⁻⁵Torrの真空下で、 真空蒸着法により厚さ1000オングストロームのケイ素酸化物蒸 着層を無機質層として形成し、複合フィルムを得た。

実施例1及び2

20 塩化ビニリデン系共重合体(旭化成工業(株)製、商品名サランレジンF216)を、トルエン/テトラヒドロフラン=1/2(重量比)の混合溶媒に溶解し、樹脂濃度15重量%のバリア性樹脂コーティング層用の塗布液を調製した。

この塗布液を、比較例1で得られたケイ素酸化物蒸着フィルムの 25 蒸着面に、バーコーターを用いて乾燥後の厚さ 0.5 μm (実施例 1)および 2.5 μm (実施例 2)になるように塗布した後、1 0 5 ℃のオーブンで 3 0 秒間乾燥し、バリア性樹脂コーティング層を 形成して、複合フィルムを得た。

実施例3

エチレンービニルアルコール共重合体(日本合成化学工業(株)製、商品名:ソアノール30L)を、水/イソプロパノール=1/1(重量比)の混合溶媒に溶解し、樹脂濃度12重量%のバリア性樹脂コーティング層用の塗布液を調製した。

5 この塗布液を、比較例1で得られたケイ素酸化物蒸着フィルムの 蒸着面に、バーコーターを用いて、乾燥後の厚さ4.0μmになる ように塗布した後、115℃のオーブンで1分間乾燥して、バリア 性樹脂コーティング層を形成し、複合フィルムを得た。

比較例2及び3

10 ポリエチレンテレフタレートフィルム上に、直接、厚さ 0.5 μm (比較例 2)、又は 2.5 μm (比較例 3)のバリア性樹脂コーティング層を形成した以外は、実施例 1 及び 2 と同様にして、複合フィルムを得た。

比較例4

塩化ビニリデン系共重合体を含む塗布液に代えて、一般的なウレタン系樹脂溶液 [武田薬品工業(株)製、商品名タケラック A 6 1 5] を用いて、無機質層の表面に厚さ 5. 0 μ m のコーティング層を形成した以外、実施例 1 と同様にして、複合フィルムを得た。

比較例5

20 バリア性樹脂コーティング層に代えて、無機質層の表面に、ウレタン系接着剤 [東洋モートン (株) 製、商品名ADCOTE 333E]を乾燥後の厚さが約2μmとなるように塗布し、ドライラミネート法により、厚さ30μmの未延伸エチレンープロピレン共重合体フィルムを積層する以外、実施例1と同様にして、複合フィル25ムを得た。

比較例6

塩化ビニリデン系共重合体を含む塗布液に代えて、塩化ビニルー 酢酸ビニル共重合体溶液 [電気化学工業 (株) 製、商品名デンカ1 000C] を用いて、無機質層の表面に厚さ2.5μmのコーティ ング層を形成した以外は、実施例2と同様にして、複合フィルムを 得た。

比較例7

厚さ12μmの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの 5 一方の面に、実施例2のバリア性コーティング塗布液を用いて、厚さ2.5μmのコーティング層を形成した。次いで、前記コーティング層の表面に、比較例1と同様にしてケイ素酸化物蒸着層を形成し、複合フィルムを得た。

そして、実施例及び比較例で得られたガスバリア性フィルムの酸 10 素ガス透過率、及び水蒸気透過率を次のようにして評価した。

酸素ガス透過率:

同圧法 (測定器: Morcon社OXTRAN TWIN) により、20℃、相対湿度65%の条件で測定した。単位はcc/m²・24hrである。水蒸気透過率:

15 測定器 (Morcon社 PERMATRAN W200) を用い、40℃、相対湿度9 0%の条件で測定した。単位は、g/m²・24hrである。

また、手でフィルムを1回揉み、その前後の酸素ガス透過率及び 水蒸気透過率を測定し、機械的外力の作用によるガスバリア性の変 化を評価した。

20 結果を表1に示す。なお、実施例3のフィルムにおいて、手揉み 前の酸素透過率は、測定限界以下であった。

表1から明らかなように、比較例1~7のフィルムは、ガスバリア性が十分でなく、比較例1、6及び7のフィルムは、手揉みによるガスバリア性の低下が著しい。これに対して、実施例1~3のフィルムは、ガスバリア性が極めて高いだけでなく、手揉みなどの機械的外力が作用しても、優れたガスバリア性を維持できる。特に、比較例1~3との対比から明らかなように、無機質層およびバリア性樹脂コーティング層とを組合せることにより、被覆層の厚みが小さくても極めて高いガスバリア性を示す。

•		
:	ł	ž
	•	`

	バリア性樹脂	酸素泛	酸素透過率	 本题函题版本	多過率
	コーティング圏	(c c / m ²	n ² • 24hr)	(g/m ²	· 24hr)
	(m m)	手様み前	手様み後	手揉み前	下保み後
実施例1	0.5	0.05	0.2	0.7	2. 6
実施例2	2.5	0,01	0.3	0.3	1. 9
実施例3	4.0	< 0, 01	0.3	0.2	2. 0
比較例1	•	2. 3	15.2	2.8	16.0
比較例2	0.5	13. 2	13. 2	10.8	10.8
比較例3	2.5	10.5	10.5	8.8	8.8
比較例4	5.0	2. 3	3.9	2. 6	4.8
比較例5	3.0	1.5	1.6	1.3	3.5
比較例6	2.5	2. 0	5.3	2. 0	4.8
比較例7	2.5	0.8	5. 2	1. 2	6. 2

実施例4

塩化ビニリデン系共重合体(旭化成工業(株)製、商品名サランレジンF216)を、トルエン/テトラヒドロフラン=1/2(重量比)の混合溶媒に、樹脂濃度が15重量%になるように溶解し、バリア性樹脂コーティング層塗布液を調製した。この塗布液を、前記蒸着面に、乾燥後の厚さ1μmになるように塗布した後、乾燥し、バリア性樹脂コーティング層を形成した。

さらに、バリア性樹脂コーティング層の表面に、ポリエステル系接着剤を3μmの厚さに塗布し、80℃で20秒間乾燥した後、2kg/cm²の加圧下で100℃、1秒間の条件で、厚さ40μm 5の無延伸ポリプロピレンフィルムをドライラミネートして、包装用フィルムを作製した。

実施例5

実施例6

エチレン・ビニルアルコール共重合体(日本合成化学工業(株)製、商品名:ソアノール30L を、水/イソプロパノール=1/20 1 (重量比)の混合溶媒に溶解し、樹脂濃度12重量%のバリア性樹脂コーティング層用塗布液を調製した。実施例4の塗布液に代えて、エチレン・ビニルアルコール共重合体を含む前記塗布液を用いる以外、実施例4と同様にして、包装用フィルムを作製した。

基材フィルムとして厚さ20μmの二軸延伸ナイロンフィルムを用い、このフィルムの一方の表面に、SiOを蒸発源として、5×10⁻⁵Torrの真空下で、真空蒸着法により厚さ600オングストロームのケイ素酸化物蒸着層を形成する以外、実施例4と同様にして、包装用フィルムを作製した。

実施例7

実施例4と同様にして形成したケイ素酸化物蒸煮面に、バリア性 樹脂コーティング層塗布液を乾燥後の厚さ 0.5 μ m となるように 塗布する以外、実施例4と同様にして、包装用フィルムを作製した。

5 実施例8

実施例4と同様にして基材フィルムの一方の面に形成したバリア性樹脂コーティング層の表面に、二液型ウレタン系接着剤を2μmの厚さに塗布し80℃で10秒間乾燥した後、2.5kg/cm²の加圧下で、厚さ50μmの直鎖低密度ポリエチレンフィルムをドライラミネートする以外、実施例4と同様にして、包装用フィルムを作製した。

比較例8

バリア性樹脂コーティング層を形成することなく、無機質層の表面に、実施例4と同様にして、ポリエステル系接着剤により、厚さ 40μmの無延伸ポリプロピレンフィルムをドライラミネートし、 包装用フィルムを作製した。

比較例9

ケイ素酸化物蒸着層を形成することなく、厚さ12μmのポリエチレンテレフタレートフィルムに、実施例4の塩化ビニリデン系共 重合体を含む塗布液を塗布し、乾燥後の厚さ5μmのバリア性樹脂コーティング層を形成した後、実施例4と同様にして、ポリエステル系接着剤により、厚さ40μmの無延伸ポリプロピレンフィルムをドライラミネートし、包装用フィルムを作製した。

比較例10

25 厚さ12μmのポリエチレンテレフタレートフィルムに、厚さ12μmのアルミニウム箔をドライラミネートした後、実施例4と同様にして、ポリエステル系接着剤により、厚さ40μmの無延伸ポリプロビレンフィルムをドライラミネートし、包装用フィルムを作製した。

得られた包装用フィルムのガスバリア性、透明性、電子レンジ適性を、次のようにして調べた。

ガスバリア性試験:酸素ガス透過率はMOCON法、水蒸気透過率はJIS-Z-0208に従って、酸素ガス、水蒸気の透過率を5 測定した。

透明性:130℃、20分間のレトルト処理の前後で目視により 評価した。

電子レンジ適性:実施例4、5および比較例8~10の包装用フィルムを袋にし、各袋にスパゲティー用ミートソース200gを詰めて、家庭用電子レンジで加熱した。電子レンジ加熱の所要時間は、比較例9のフィルムが95秒程度であったのに対して、実施例4、5および比較例8のフィルムは75秒程度であった。なお、比較例10のフィルムは導電性のアルミニウム箔がスパークし、電子レンジによる加熱ができなかった。

15 電子レンジ適性は、これらの結果に基づいて、下記の基準により 総合的に評価した。

優 :電子レンジによる加熱が可能であり、かつ時間が短い

良 :電子レンジによる加熱が可能であるが、時間が長い

不可:電子レンジによる加熱が不可能

20 得られた結果を表2に示す。

表2から明らかなように、実施例のフィルムは比較例のフィルムに比べて、高い透明性及びガスバリア性を有し しかも加熱により、これらの特性がさほど低下しない。従って、実施例のフィルムは、レトルト処理及び電子レンジ加熱において、総合的に優れた適性を25 有する。

表 2

		実施例4	実施例5	実施例6 実施例7		実施例8	比較例8	15核例9	LENSMI9 LENSMI10
バリア性樹脂コーティング層の厚さ (μm)	イング層の厚さ		ı		0.5	-	ı	5	:
	レトルト処理前	0.05	0. 1	0. 2	0. 1	0. 2	1.5	٦	0.03
(cc/m ² · 24hr) 1	レトルト処理後	0.5	0.8	0.7	0.5	0.6	1.5	3.0	0.03
	レトルト処理前	0.4	0.6	0.8	0.4	0.3	2. 8	3	0. 2
(g/m² · 24hr) 1	レトルト処理後	0.9	1. 0	0.9	0.5	0.6	3, 2	2.0	0. 2
7 世	レトルト処理前	侹	極	斑	優	飯	優	愈	不可
	レトルト処理後	優	優	極	極	優	逐	良	不明
電子レンジ適性	氧性	優	優	極	- 適	優	凾	良	不可

請求の範囲

- 1. 基材フィルム層の少なくとも一方の面が、透明性を有する無機質層を介して、バリア性樹脂コーティング層で被覆されているガスバリア性フィルム。
- 基材フィルム層が、オレフィン系ポリマー、ポリエステ
 ル、ポリアミド、スチレン系ポリマー、エチレンービニルアルコール共重合体、ポリカーボネート又はポリアクリロニトリルで構成されている請求項1記載のガスバリア性フィルム。
- 3. 基材フィルム層が、ポリプロピレン、ポリアルキレンテレフタレート又はポリアミドで構成されている請求項1記載のガス 10 バリア性フィルム。
 - 4. 無機質層が、周期景 2 A 族元素、遷移元素、 2 B 族元素、 3 B 族元素、 4 B 族元素および 6 B 族元素から選ばれた少なくとも 1 つの金属単体又はその無機化合物で構成されている請求項 1 記載のガスバリア性フィルム。
- 15 5. 無機化合物が、無機酸化物である請求項4記載のガスバリア性フィルム。
 - 6. 無機質層が、周期表 3 B 族元素又は 4 B 族元素の酸化物で構成されている請求項 1 記載のガスバリア性フィルム。
- 7. 透明性を有する無機質層が、ケイ素酸化物で構成されて 20 いる請求項1記載のガスバリア性フィルム。
 - 8. 無機質層の厚みが、100~5000オングストロームである請求項1記載のガスバリア性フィルム。
- 9. バリア性樹脂コーティング層が、塩化ビニリデン系共重合体又はエチレンービニルアルコール共重合体を含む請求項1記載 25 のガスバリア性フィルム。
 - 10. 塩化ビニリデン系共重合体が、塩化ビニリデン-アクリロニロリル共重合体、塩化ビニリデン-メタクリル酸共重合体、塩

化ビニリデンーアクリレート共重合体、塩化ビニリデンーメタクリレート共重合体、または塩化ビニリデンー酢酸ビニル共重合体である請求項9記載のガスバリア性フィルム。

- 11. エチレン-ビニルアルコール共重合体が、エチレン含量 5 5~50モル%の溶媒可溶性エチレン-ビニルアルコール共重合体 である請求項9記載のガスバリア性フィルム。
 - 12. バリア性樹脂コーティング層の厚さが $0.05\sim15\mu$ mである請求項1記載のガスバリア性フィルム。
- 13. 透明性を有する無機質層の厚さ n! (μm) に対するバ
 10 リア性樹脂コーティング層の厚さ n2 (μm) の割合 n2 / n1 が、
 0. 1~1500である請求項1記載のガスバリア性フィルム。
 - 14. 透明性を有する無機質層の厚さnlが100~5000 オングストローム、バリア性樹脂コーティング層の厚さn2が0.

15. ポリプロピレン、ポリアルキレンテレフタレート又はポ

 $1\sim 10~\mu$ mであり、前記無機質層の厚さ $n1~(\mu m)$ に対するコーティング層の厚さ $n2~(\mu m)$ の割合n2~/n1 が $1\sim 200$ である請求項1記載のガスバリア性フィルム。

リアミドで構成された基材フィルム層の少なくとも一方の面に、組成式SiOx (式中、O<x至2)で表されるケイ素酸化物で構成され、かつ厚み2OO~3OO0オングストロームの無機質層と、塩化ビニリデン系共重合体又はエチレンービニルアルコール共重合体で構成されたバリア性樹脂コーティング層とがこの順に形成されているとともに、前記無機質層の厚さ n1 (μm) に対するバリア性樹脂コーティング層の厚さ n2 (μm) の割合 n2 / n1 が1~25 100である請求項1記載のガスバリア性フィルム。

- 16. 基材フィルムの他方の面またはバリア性樹脂コーティング層が、ヒートシール層で被覆されている請求項1記載のガスバリア性フィルム。
 - 17. ヒートシール層が、オレフィン系ポリマー、酢酸ビニル

- 塩化ビニル共重合体、ポリエステル、ポリアミド及びゴム系ポリマーから選択された熱接合性ポリマーで構成されている請求項16記載のガスバリア性フィルム。
- 18. ポリアルキレンテレフタレート又はポリアミドで構成された基材フィルム層の少なくとも一方の面に、非導電性無機物で構成され、かつ厚み200~3000オングストロームの無機質層、厚み0.1~10μmのバリア性樹脂コーティング層、およびヒートシール層がこの順に形成され、レトルト処理または電磁波加熱用食品を包装するための請求項16記載のガスバリア性フィルム。
- 10 19. ポリアルキレンテレフタレート又はポリアミドで構成された基材フィルム層の少なくとも一方の面に、非導電性無機物で構成され、かつ厚み200~3000オングストロームの無機質層、および厚み0.1~10μmのバリア性樹脂コーティング層がこの順に形成され、前記基材フィルムの他方の面に、ヒートシール層が形成され、レトルト処理または電磁波加熱用食品を包装するための請求項16記載のガスバリア性フィルム。
 - 20. 基材フィルムの少なくとも一方の面に、透明性を有する無機物の被膜を形成した後、厚さ2μmにおいて、温度25℃で酸素ガス透過率が20cc/m²・24時間以下、温度40℃及び90%相対湿度で水蒸気透過率が20g/m²・24時間以下のバリア性樹脂を含む塗布液を塗布し、コーティング層を形成するガスバリア性フィルムの製造方法。
- 21. ケイ素酸化物を用いて無機質層を形成するとともに、塩化ビニリデン系共重合体又はエチレン-ビニルアルコール共重合体 を含む溶液又は分散液を用いてコーティング層を形成する請求項 2 0 記載のガスバリア性フィルムの製造方法。
 - 22. コーティング層又は基材フィルムの他方の面に、厚み3~100μmのヒートシール層を形成する請求項20記載のガスバリア性フィルムの製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP94/01525

A. CLA	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
Int.	. C1 ⁵ B32B9/04	۵			
According (According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIEI	DS SEARCHED				
Minimum de	ocumentation searched (classification system followed b	: Classification symbols)			
Int.	. C1 ⁵ B32B9/00, 9/04, 27/06	, 27/28, 27/30			
Jits	ion searched other than minimum documentation to the e suyo Shinan Koho 192 ai Jitsuyo Shinan Koho 197	6 - 1994	ne fields searched		
ļ	ata base consulted during the international search (name		erms used)		
<u> </u>	and only ordered damag are international scarcii (name	or data base and, where practicable, scaren	erius esce)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X Y	JP, A, 2-58023 (Mitsubishi Co.), February 27, 1990 (27. 02. (Family: none)		16, 17, 22 1-15, 18-21		
х, ч	US, A, 5100720 (MITSUBISHI March 31, 1992 (31. 03. 92 & JP, A, 2-34328 & JP, A, & JP, A, 1-95038 & EP, A,) 1-184127	1-22		
х, ч	JP, A, 1-283135 (Mitsubish Co.), November 14, 1989 (14. 11.		1-22		
Х, У	JP, A, 1-267032 (Mitsubish Co.), October 24, 1989 (24. 10.		1-22		
Х, У	JP, A, 1-165434 (Mitsubish Co.), June 29, 1989 (29. 06. 89)				
V Fuethe					
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Second categories of cited documents: Second categ					
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention					
"E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other					
	special reason (as specified) "Y" document of particular relevant the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other, uch documents, such combination				
	ent published prior to the international filing date but later than rity date claimed	being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent			
	ember 30, 1994 (30. 11. 94)	Date of mailing of the international sea December 20, 1994 (•		
Name and m	nailing address of the ISA/	Authorized officer			
	inese Patent Office				
	Facsimile No. Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP94/01525

		<u>_</u>	
C (Continu	uation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the releva	nt passages	Relevant to claim No.
X Y	JP, A, 60-244540 (Toyo Ink Mfg. Co., Lt December 4, 1985 (04. 12. 85), (Family:	d.), none)	1-15, 20, 21 16-19, 22
Y	JP, A, 1-202436 (Onoike Kogyo K.K.), August 15, 1989 (15. 08. 89), (Family:	none)	18, 19
Y	JP, A, 1-202435 (Onoike Kogyo K.K.), August 15, 1989 (15. 08. 89), (Family:	none)	18, 19

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類([PC))

Int. CL⁵ B32B9/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. CL⁵ B32B9/00,9/04,27/06,27/28,27/30

我小限資料以外の資料で調査を行った分野に含ま: ,の

日本国実用新案公報

1926-1994年

日本国公開実用新案公報

1971-1994年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP,A,2-58023(三菱モンサント化成株式会社), 27.2月.1990(27.02.90)(ファミリーなし)	16,17,22 1-15, 18-21
Х,Ү	US,A,5100720(MITSUBISHI MONSANTO KK), 31.3月.1992(31.03.92) &JP,A,2-34328&JP,A,1-184127 &JP,A,1-95038&EP,A,311432	1-22

✔ C個の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日 若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日 の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と 矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のため に引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規 性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

C(続き).		47 01323
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Х, Ү	JP,A,1-283135(三菱モンサント化成株式会社), 14.11月.1989(14.11.89)(ファミリーなし)	1-22
Х, Ү	JP,A,1-267032(三菱モンサント化成株式会社), 24.10月.1989(24.10.89)(ファミリーなし)	1-22
X , Y	JP,A,1-165434(三菱モンサント化成株式会社), 29,6月,1989(29,06,89)(ファミリーなし)	
X Y	JP,A,60-244540(東洋インキ製造株式会社), 4.12月.1985(04.12.85)(ファミリーなし)	1-15,20, 21 16-19,22
Y	JP,A,1-202436(尾池工業株式会社), 15.8月.1989(15.08.89)(ファミリーなし)	18,19
Y	JP,A,1-202435(尾池工業株式会社), 15.8月.1989(15.08.89)(ファミリーなし)	18,19